



Toshiba introduce i MOSFET per automotive a 40V con RDS(on) ultra bassa in package da 5mm x 6mm con raffreddamento su due lati

I nuovi package migliorano le prestazioni termiche

Düsseldorf, Germania, 4 Settembre 2018 – Toshiba Electronics Europe annuncia il lancio dei MOSFET di potenza a canale N da 40V "TPWR7940PB" e "TPW1R104PB", che utilizzano package DSOP Advance (WF) con capacità di raffreddamento su due lati. Il TPWR7940PB è un MOSFET da 40V con una RDS(on) massima di 0,79mΩ nel package DSOP Advance (WF)L e il TPW1R104PB è un MOSFET da 40V con una RDS(on) massima di 1,14mΩ nel package DSOP Advance (WF)M. Entrambi i dispositivi sono basati sul più recente processo U-MOSIX-H con struttura trench e sono qualificati AEC-Q101. Essi si rivolgono ad applicazioni automotive quali il servosterzo elettrico (EPS), i sezionatori di carico e le pompe elettriche.

Sia il DSOP Advance (WF)M, sia il DSOP Advance (WF)L sono package da 5mm x 6 mm a 8 pin. IL DSOP Advance (WF)M e il DSOP Advance (WF)L differiscono in termini di area di superficie esposta della piastra metallica superiore. Essa è di circa 8mm² nel package DSOP Advance (WF)M e di circa 12mm² nel DSOP Advance (WF)L. Misurata in un ambiente di test di Toshiba, la massima impedenza termica fra il canale e la piastra superiore è di 1,5K/W per il package TPW1R104PB e di 0,93K/W per il TPWR7940PB. Le loro eccellenti prestazioni termiche sono state ottenute collegando l'area esposta a un dissipatore di calore (come ad esempio un telaio metallico) tramite uno strato isolante.

I package DSOP Advance (WF)M e DSOP Advance (WF)L sono compatibili con l'ingombro del package SOP Advance (WF) che non presenta un'area esposta metallica sulla sommità. I package DSOP Advance (WF)M e DSOP Advance (WF)L sfruttano una struttura di terminale a fianco bagnabile che consente l'ispezione ottica automatica (AOI) dei giunti di saldatura su PCB. L'AOI è particolarmente importante nelle applicazioni automotive, in cui è richiesta la verifica della qualità della saldatura.

La produzione in volumi del TPWR7940PB e del TPW1R104PB ha avuto inizio nell'Agosto 2018.

###

Informazioni su Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) è la divisione Europea dedicata alla produzione di componenti elettronici di [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#). TEE offre ai consumatori e alle aziende Europee un'ampia varietà di unità a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per applicazioni automotive, industriali, IoT, per il controllo del movimento, telecom, di rete, consumer e per gli elettrodomestici. Il vasto portafoglio di prodotti della società comprende IC wireless integrati, semiconduttori di potenza, microcontrollori, semiconduttori ottici, ASIC, ASSP e dispositivi discreti che vanno dai diodi agli IC logici.

TEE ha sede principale a Düsseldorf in Germania, con filiali in Francia, Italia, Spagna, Svezia e nel Regno Unito con attività di progettazione, produzione, marketing e vendite. Il presidente della compagnia è il sig. Tomoaki Kumagai

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web di Toshiba Electronics Europe all'indirizzo www.toshiba.semicon-storage.com.

Indirizzo di riferimento da pubblicare:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germania

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

E-mail: discrete-ic@toshiba-components.com

Contatto per i giornalisti:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)193 282 2832

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Comunicato emesso da:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

Web: www.publitek.com

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Settembre 2018

Rif. 7166/A